

生益电子股份有限公司

关于 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的

半年度评估报告

生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司结合发展阶段、行业特点、投资者建议等研究制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。报告期内，公司按照行动方案有力有序推进相关工作的开展，在市场、研发、运营管理、公司治理等多方面持续发力，2026 年上半年实施情况和实施效果主要如下：

一、深耕印制线路板主业，持续提升经营质量

（一）经营效益高质量发展，行业竞争力持续提升

报告期内，公司聚焦主业，推进经营管理高质量发展，实现营业收入 57.84 亿元，同比增长 53.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 11.11 亿元，同比增长 109.36%，净利润增速高于营收增速，盈利质量与经营效益进一步提升。根据中国电子电路行业协会发布的《2025 年中国电子电路行业主要企业营收表》，公司 PCB 业务规模位列第 13 位、排名内资企业第 6 位，行业地位和竞争力进一步加强。

（二）高端产品持续放量，产品结构向高附加值升级

公司紧抓 AI 算力领域行业红利，集中资源推动产品高端品类放量，高端产品收入占比持续提高，成为业绩增长核心驱动。其中，服务器、交换机等数据中心相关产品收入稳步增长，核心产品顺利通过全球头部算力平台认证并实现规模化批量交付；1.6T 交换机配套 PCB 进入小批量量产阶段，进一步巩固高速互联领域竞争优势；高速光模块 PCB 出货规模稳步提升；卫星通信板块产业化落地有序推进。产品结构高端化升级成效显著。

（三）客户布局持续深化，增长基础不断夯实

公司依托优质存量客户基础，持续深化与全球头部云厂商、服务器厂商、算力平台企业的战略合作，绑定下游核心客户技术迭代路线开展同步研发与技

术协同；同时稳步推进新客户认证与市场开拓，客户结构持续优化，为业务长期增长筑牢坚实基础。

（四）募集资金管理规范有序，重大项目稳步建设

报告期内，公司严格遵守募集资金管理相关法律法规，规范募集资金使用与专户管理，募投项目资金拨付严格履行审批流程，不存在违规使用、变更投向等情形，持续保障资金使用效率与合规性。公司重大产能建设项目有序推进，高端产品供给能力稳步增强：

1、关于东莞智能算力中心高多层高密互连电路板项目

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资智能算力中心高多层高密互连电路板项目的议案》，决议在公司东莞制造基地现有厂房投资智能算力中心高多层高密互连电路板项目，项目计划投资总额约 14 亿元人民币，分两期建设，其中一期投资额约 10 亿元人民币，二期投资额约 4 亿元人民币。2025 年 5 月 12 日，经 2024 年年度股东大会审议表决，项目一期变更为募投项目。因项目一期达到预定可使用状态，公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，公司董事会审议同意调整项目一期内部投资结构和投资总额并结项。报告期内，项目一期正式投产并持续产能爬坡，产出与运营效益稳步提升；二期按计划推进建设与设备部署，并已于报告期内逐步投入使用。根据市场需求，项目重点布局 AI 算力高多层产品，下半年公司将持续推进项目提产扩产，进一步扩充 AI 数据中心高多层 PCB 供给能力。

2、关于吉安智能制造高多层算力电路板项目

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资智能制造高多层算力电路板项目的议案》。结合市场发展趋势，根据公司新一轮战略规划和对内外部需求的充分调研评估，公司计划在吉安二期项目现有厂房的部分楼层投资本项目，项目计划投资总金额约 19 亿元人民币，包括但不限于公共设施、生产设备、检测设备等相关投入，其中包括吉安二期项目相应楼层已投入的厂房建设、设备等费用。项目计划分两阶段实施，每阶段各年产 35 万平方米。报告期内，项目高效推进，公共设施施工和设备安装调试工作有序实施，项目第一阶段于 2026 年 6 月实现全流程贯通试生产，助力公司中高端产能扩充；同时，报告期内公司提前启动项目第二阶段建设工作，为公司

抢抓高端市场、持续优化产品结构提供支持。项目全部建成后达产年产能将达70万平方米，有利于显著提升公司中高端高多层板产能规模，进一步匹配AI算力市场增量需求。

3、关于泰国工厂一期项目

公司于2023年7月正式启动泰国生产基地建设项目。2025年泰国公司完成厂房主体建筑封顶，并全面展开公共设施的安裝与机电配套工程。报告期内，公司大力推进项目工程建设工作，进入生产设备安装调试、试生产筹备阶段；同步搭建本地化运营团队，完善属地合规管理体系与供应链配套方案，全力冲刺2026年第三季度试生产节点，全球化产能布局持续深化。

4、关于人工智能计算HDI生产基地建设项目

公司于2025年11月17日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，同意公司在东莞市东城街道投资建设人工智能计算HDI生产基地项目。项目计划总投资约20亿元人民币，投资内容包括但不限于土地购置、厂房土建、公共设施、生产设备及检测设备等。报告期内，项目已完成厂房土建工程设计、审图和招标等工作，并于2026年5月底进入土建工程基础施工阶段，计划2028年试生产。公司将全力推进工程建设，确保按计划完成厂房土建工程及公共设施安装等工作。项目建成后，将提升公司在人工智能计算HDI领域的产能配置，进一步增强公司市场竞争力。

二、培育新质生产力，强化前沿技术攻关与成果落地

（一）研发布局紧扣新质赛道，持续筑牢技术底座

报告期内，公司紧扣年度工作主线，围绕新质生产力培育方向持续加大研发投入，聚焦高端前沿赛道统筹技术攻关布局。2026年上半年新增立项研发项目10项，项目重点覆盖高端服务器、高速网络、卫星通信、无线通信及智能汽车电子等领域；公司将AI算力基础设施PCB作为核心研发主线，集中资源攻坚高速、高多层、高阶HDI、mSAP核心工艺，全方位迭代升级AI服务器配套产品技术体系，为新质生产力领域产品供给筑牢技术底座。

（二）研发成果加速落地转化，创新赋能提质增效

公司持续推动技术成果向产业化端落地，构建“研发-验证-量产”的转化闭环，研发价值向经营效益的传导效率持续提升。报告期内，30层以上高多层板、高阶产品技术能力大幅升级；1.6T交换机配套PCB实现小批量量产；卫星通信领域相关技术达到产业化应用要求。前沿技术成果快速转化为产品供给能力，有效支撑高端产品结构升级与经营效益提升。

（三）知识产权体系前瞻布局，标准化建设同步深化

报告期内，公司提前布局关键技术与知识产权保护体系，同步推进技术攻关与知识产权全链条管理，专利布局重点技术领域。2026年上半年累计申请专利及软件著作权13件，新增授权专利及软件著作权12件，其中新增发明专利7项。标准化建设协同推进，报告期内发布生效技术标准5项，其中含2项国际标准，行业技术话语权进一步提升；发表技术论文3篇，行业技术影响力持续扩大，持续打造技术创新的机制保障。

三、持续完善公司治理机制，提升治理效能

（一）完善治理制度，积极推进公司治理运作

1、有序完成董事会换届工作，保障公司治理平稳有序过渡

报告期内，公司顺利完成董事会换届工作，为公司的平稳过渡和持续治理提供了保障。公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了董事会换届相关议案，提名了第四届董事会非独立董事和独立董事候选人。2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制选举邓春华先生、陈仁喜先生、张莉女士、唐庆年先生、唐芙云女士为公司第四届董事会非独立董事，选举李焰文先生、储小平先生、庞春霖先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月14日，公司召开职工代表大会，选举张恭敬先生为公司第四届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会非职工代表董事一致，从股东会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事之日起三年。

2026年5月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生了董事长、第四届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会、提名委员会的成员及召集人，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上；同时，会议审议通过并聘任了公司新一届高管团队以及审计部负责人、证券事务代表。

2、坚持稳健、可持续分红策略，持续提升投资者回报

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 167,972.7119 万元。根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2025 年度利润分配实施时公司总股本 83,182.1175 万股，扣减公司回购专用证券账户所持有的本公司股份 879.4116 万股，实际可参与利润分配的股数为 82,302.7059 万股，以此计算合计派发现金红利 49,381.6235 万元（含税）。2026 年 6 月 5 日公司实施完成本次利润分配。

3、稳步推进股份回购，促进公司可持续发展

公司按照 2025 年度股份回购方案，在 2026 年第一季度积极推进实施股份回购工作，截至 2026 年 3 月 2 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 559,847 股，占公司总股本的比例为 0.0673%，回购的最高成交价为 99.74 元/股，最低成交价为 84.15 元/股，支付的资金总额为人民币 5,000.7062 万元（不含交易佣金等交易费用）。回购完成后，上述回购股份均存放于公司回购专用证券账户，公司根据回购方案用于实施股权激励或员工持股计划。

（二）持续深化内部审计和内部控制工作，强化风险防范

报告期内，审计部根据年度审计计划及实际业务需求，开展了多项内控审计、合规审计，主要包括吉安子公司二期公共设施工程建设内控管理审计、泰国子公司公共设施建设管理审计、东城五厂公共设施工程管理审计、每季度的募集资金使用情况审计等。

经审计评估，公司整体内控制度在设计和执行层面合理有效，未发现重大或较大的内控缺陷。审计部对重大投资项目的关键环节实施审计监督，包括事前监督方案制定及决策流程、供应商招投标、事中监督项目施工的质量、进度、安全、成本管控及合同履行等，公司各重大投资项目全流程风险可控，均按计划有序推进。审计部每季度持续监督公司募集资金的存放与使用情况，确认公司不存在募集资金管理的违规情形。

（三）推动实施再融资项目，助力公司高质量可持续发展

2025 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案，并于 2025 年 12 月 4 日召开的股东会审议通过以上议案，同时根据 2026 年 3 月 12 月召开的第三届董事会第三十六次会议，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 252,950.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于人工智能计算 HDI 生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款。报告期内，公司坚持以规范的公司治理和守法合规经营为基础，有序推动 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关工作。2026 年 2 月 11 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理生益电子股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，本次再融资项目的申请文件被上交所正式受理并进入审核阶段。3 月 21 日公司在上海证券交易所网站公告《2025 年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》。5 月 20 日公司收到上海证券交易所出具的《关于生益电子股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，上海证券交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。6 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意生益电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效，公司将结合实际情况在规定期限内办理发行相关事项。

四、强化管理层与股东利益的共担共享约束以及“关键少数”的责任

报告期内，公司持续完善公司治理机制，强化“关键少数”的责任。公司于 2026 年 4 月 24 日披露了新修订的《生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度旨在进一步贯彻《上市公司治理准则》等最新监管要求，完善

公司董事、高管薪酬管理机制。制度明确了董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，并强调绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，建立了止付追索制度，确保薪酬水平与市场发展、个人能力业绩及公司长期利益深度绑定。

同时，公司持续组织公司董事、高管以及公司关键岗位人员参加内外部治理培训，组织了内幕信息管理培训、舆情管理培训、募集资金使用和管理培训等内部培训，并组织董事、高管参加监管机构和交易所组织的合规培训，持续提升履职能力和风险防范能力。

在股权激励方面，公司积极落实 2024 年限制性股票激励计划的归属工作，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性。2026 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 14,564,175 股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 490 名激励对象办理归属相关事宜。本次归属股票中，5,770,059 股来源于公司向激励对象定向发行的 A 股普通股，已于 2026 年 6 月 16 日完成登记并于 2026 年 6 月 23 日上市流通。另有 8,794,116 股来源于公司从二级市场回购的股份，已于 2026 年 6 月 24 日完成过户登记。通过上述举措，公司有效实现了管理层、核心员工与股东利益的共担共享，激发了关键人才提升公司价值的积极性与主动性。

五、加强投资者沟通交流，完善投资者意见征询与反馈

报告期内，公司积极落实投资者沟通计划，通过多种渠道与投资者保持了开放、透明的沟通，有效加强了投资者对公司的了解与信任。公司于 2026 年 5 月 7 日以视频录播和网络互动的形式举办了 2025 年度及 2026 年一季度业绩说明会。公司董事长、总经理、董事会秘书兼财务总监、独立董事等核心管理层参与，就公司 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果与投资者进行了互动交流。同时，公司于 2026 年 6 月举办了两场路演投资者关系活动，公司向投资者介绍了经营情况、财务数据、产品应用领域、项目建设进展及行业前景等内容，

并回应了投资者关心的产能利用率、原材料影响等问题。同时公司还通过投资者热线、上证E互动多层次、多形式地与投资者进行了有效沟通，有效执行行动方案中“完善投资者意见征询和反馈机制”、“丰富投资者接待形式”的计划，进一步增进投资者对公司的信任与支持。

六、其他事宜

下半年，公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的具体举措计划，及时履行信息披露义务。公司将继续专注印制电路板主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

生益电子股份有限公司董事会

2026年8月15日